

TG 系列导热硅脂

高性能，低热阻导热界面材料

TG系列导热硅脂是一种高导热系数的导热硅脂，可以有效降低散热器及发热源之间的接触热阻。适用于需要最小压缩厚度、恒定压力和易于丝网印刷以获得最佳性能的应用场合。AOK的高性能硅脂产品的设计宗旨是通过消除泵出在大多数应用场合中保证最大化的可靠性。



特性和优点

- 导热系数1.0~5.0 W/m.K可选
- 低油离度（趋于0）
- 长效型，可靠性佳
- 接触面湿润效果佳，有效降低界面热阻
- 耐候性强（耐高低温、耐水气、耐老化等）

采购信息

包装规格：30 ml PE 管/1 Kg 罐装/2 Kg 罐装/10 KG 灌装

使用说明及注意事项

先将涂抹表面清洁乾淨，然后将硅脂搅拌均匀，之后可采用点涂、刷涂或丝网印刷的方式将硅脂涂抹覆盖在该表面上。若采用丝网印刷，建议采用60-80目的尼龙丝网，选用硬度为70左右的橡胶刮刀，在涂覆时，与涂覆表面呈45度左右刮涂硅脂。操作结束后，未用完的产品应及时密封保存。

存储运输

储藏于阴凉、干燥、通风处。本产品为无毒非危险性，按一般化学品搬运和运输即可。

保质期

6个月

典型属性

属性	标称值					测试方法
	TG 100	TG 200	TG 300	TG 400	TG 500	
型号						-
组成部分	不硫化型硅油与导热填料混合物					-
颜色	白色	白色	灰色	灰色	灰色	目视
粘度 (mPa·s)	40,000	2,000,000	2,000,000	2,500~3,500	3,000~4,000	ASTM D2196
密度 (g/cc)	2.8	2.9	3.1	2.5	2.5	ASTM D792
锥入 (25°C, 0.1mm)	300±20	280±20	250±20	230±20	220±20	HG/T269
耐温范围(°C)	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150	-
电性能						
击穿电压(Kv/mm)	6.0	5.0	-	-	-	ASTM D149
热性能						
导热系数(W/m-K)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	ASTM D5470
热阻(°C ·in ² /W) 0.1mm @40 psi	0.15	0.1	0.065	0.055	0.050	ASTM D5470

典型应用

- IT--笔记本、服务器、电脑、存储模组
- 网络通讯设备--无线模块、路由器
- 消费类电子--游戏系统、便携设备
- 工业--电源、LED照明、工控设备